集束イオンビーム励起化学気相法によるマイクロ構造体の

作製と機械的性質の評価

Mechanical Properties of Micro Structures Fabricated by Focused Ion Beam Chemical

Vapor Deposition

松室昭仁[†],高木 誠[†] A. Matsumuro[†] and M. Takagi[†]

Abstract Three-dimensional micro structures fabricated by focused ion beam chemical vapor deposition (FIB-CVD) are expected to be used as structural materials for MEMS / NEMS. In this research, the square micro structures were fabricated by FIB-CVD using probe currents of 48, 200, 1300 and 5200 pA, and Vickers hardness tests of the micro structures were carried out. The Vickers tests revealed that the hardness of the micro structure depends on the probe current density. The cross-sectional TEM observations indicated that the micro structure has an amorphous phase. The results show that the consistent fabrication process of the micro structure with both ends fixed by the FIB-CVD method was established. Mechanical properties of the micro structure with beam shape were investigated by three-point bending tests. Using a nano-indentation apparatus, the bending tests showed that Young's modulus of a beam-shaped structure was 20 ± 2 GPa and the fracture stress was 2.2 ± 0.1 GPa. Furthermore, SEM observation of the cleavage surface on a beam-shaped structure after failure showed brittle fracture. SEM-EDS images revealethat a homogeneous composition distribution of 94 at.% carbon and 6 at.% gallium over the entire micro structure.

1. 緒言

現在, 微細加工技術によって作製した3次元微小構造体の MEMS/NEMS への応用が期待されている. その技術の確立によって,立体配線による電子デバイスのさらなる小型化,超微小医療機器などの作製が実現すると考えられている.そのため,ナノテクノロジーの発展に伴い,様々な3次元微小構造体の作製方法が研究・開発されてきた.しかし,実用化されている微細加工技術では,数μmオーダーの複雑な3次元形状の微小構造体を作製することは困難である. 代表的な方法としてシリコンプロセスやLIGA プロセスが挙げられるが,これらの方法で作製できる微小構造体は準2次元的な形状であり,よって,厚さ方向に対して複雑な形状を作製することは困難である.

そこで近年,集束イオンビーム励起化学気相法 (FIB-CVD)によって3次元微小構造体を作製する方法が 開発され,その有効性が注目されている.それは,松井 らが CAD 上で自由に設計した構造を FIB-CVD によって作 製する方法を考案したことに起因する¹⁻³⁾.それらの微 小構造体は MEMS/NEMS 用の構造材料として期待されてい るが,それには微小構造体のヤング率,破壊強度といっ た機械的性質などの物性の把握が必要不可欠である.し かし,マイクローナノスケールの構造体の変形挙動には 寸法効果⁴⁻⁶⁾があることが知られており,応用に際して 構造体の外形寸法に対応するスケールごとに特性を評 価する必要がある.これまで,リソグラフィーにより作 製された静電アクチュエーターに直径 100 nm 程度の炭

*愛知工業大学 工学部 機械学科 (豊田市)

素細線を FIB-CVD により形成し引張り試験を行った報告 ⁷⁾, FIB により銅単結晶をマイクロメートルスケールに加 工し片持ち梁を作製し曲げ試験を行った報告⁵⁾や AFM に よる陽極酸化とエッチングにより一辺が数百 nm 程度の 台形断面を有する梁の3点曲げ試験を行った報告⁵⁾など 種々の材料における微小構造体の械的性質に関する報 告^{2,3),9-10)}がある.しかし, FIB-CVD による一貫したプロ セスで両端固定条件を有するマイクロメートルスケー ルの梁状試験片を作製し,3点曲げ試験により機械的性 質を評価した例はない.

そこで本研究では、FIB-CVD により作製したマイクロ メートルスケールの長方形断面を有する炭素からなる 梁状微小構造体の作製法およびナノインデンターを荷 重負荷,変位測定装置として利用した3点曲げ試験を実 現する方法を考案し、ヤング率、曲げ強度、破壊特性等 の機械的性質を評価することを目的とした.

2. 実験方法

本研究では、FIB 装置 (SII 社製 SMI2050,加速電圧 30 kV)を用いて微小構造体の作製を行った.原料の化 合物ガスにはフェナントレンガス (C₁₄H₁₀)を用い、それを ガリウムイオンの照射により分解させ、炭素からなる微 小構造体を作製した.なお、基板用材料には Si(100)単 結晶ウエハを用いた.

はじめに,作製した微小構造体のビッカース硬度を調 べるため,超微小ビッカース硬度計(Anton Paar 社製 MHT - 4)を用いて硬度測定を行った.その際,微小構



Fig. 1 Fabrication process of a beam shaped micro structure for bending tests.

マイクロメートルスケールの微小構造体のヤング率 や破壊強度等の機械的性質を調べるため、両端固定の梁 状微小構造体を作製し,両端固定条件の曲げ試験を行っ た. 梁状微小構造体の作製の概略を Fig.1 に示す. はじ めに, Fig.1(a) に示すように, TEM 観察と同様に機械 的性質に優れた構造体が得られるプローブ電流値で縦5 μm × 横5 μm × 高さ35 μmの柱状の微小構造体を 作製する.このとき、微小構造体の縦×横の寸法が5 μm×5 μmよりも若干大きくなるように作製し、後で縦 5 μm×横5 μmになるよう FIB のエッチング加工で寸 法を調整する.これとは別に,エッチング加工によりSi 基板に幅 25 μm, 深さ 10 μm の窪みを作製する. 次に, エッチング加工で柱状微小構造体を基板から切断し、そ の状態で基板ごと FIB 装置から取り出す.マニピュレー タを使用して柱状微小構造体を基板上に倒し,再び FIB 装置に入れる. そして長さが 35 μmになるように柱状 微小構造体の両端にエッチング加工を行う(Fig.1(b)). 加工後 FIB 装置から再び取り出し、マニピュレータを使 って柱状微小構造体をあらかじめ Si 基板に形成してお いた窪みにはめ込む. 最後に, 柱状微小構造体がはめ込 まれた基板を FIB 装置に入れ,柱状微小構造体の両端に, それを固定するための縦10 μm×横10 μm×高さ5 μm の構造体を FIB-CVD により作製し、柱状微小構造体を固 定する (Fig.1(c)). 以上のプロセスにより3点曲げ試 験に供する梁状微小構造体試験片を作製した.梁状微小 構造体の機械的性質を直接的に評価するため, ナノイン デンター (CSIRO 社製 UMIS2000) により曲げ試験を行っ た. その際, 曲率半径が5 µmの球状圧子を用い, 0.5, 1, 5, 10, 20 mN の微小荷重を梁状微小構造体の中央部

に加え,発生する微小変位を測定した.それによって 得られた荷重と変位の関係から梁状微小構造体のヤン



Fig. 2 SIM images of square shaped micro structures fabricatedby different probe currents: (a) 48 pA, (b) 200 pA, (c) 1300 pA, (d) 5200 pA.

グ率を算出した.なお,ヤング率の算出には,材料力学 で一般に用いられる両端固定梁の公式を用いた. 以下に概略を示す.

長さ L,幅と高さがそれぞれ $b \ge h$ の梁に,荷重 $P \ge D$ 加えるとき生じるたわみ y によりヤング率 Eは,

$$E = \frac{1}{y} \cdot \frac{PL^3}{192I_Z} \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

となる. ここで, Izは断面 2 次モーメントで

$$I_Z = \frac{bh^3}{12} \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

である. また, 破壊強度 σ β は,

$$\sigma_b = \frac{PL}{8Z} \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

である.ここで,2は断面係数で

$$Z = bh^2 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (4)$$

により算出した.

さらに、FIB-CVD で作製した微小構造体の内部の組織 および組成を調べるため、曲げ試験後の梁状微小構造体 の破面を SEM-EDS (JEOL 社製 JEM6700F)を用いて分析した.

3. 実験結果および考察

3.1 微小構造体の硬度に及ぼす作製条件の影響 Fig.2(a) ~ (d) は,それぞれ種々のプローブ電流値で 作製した微小構造体の走査イオン像 (SIM: Scanning Ion Microscopy) である. プローブ電流値 48, 200, 1300







Fig. 4 Cross - sectional TEM image and diffraction pattern of micro structure.

は所望の形状の微小構造体を作製できた(Fig.2(a)~(c)). しかし、プローブ電流値 5200 pA で作製した微小構造体 は外縁が丸みを帯び、高さも他の条件に比べて低かった. また、イオンビームによる化合物ガスの分解が十分に起 こらなかったために形成されたと考えられる溝も表面 上に見られた(Fig.2(d)).このようにビーム直径が 大きくなるプローブ電流値 5200 pA では所望の形状の微 小構造体を作製できなかった.

プローブ電流が微小構造体の硬度に及ぼす影響を調 べるため, Fig. 2 に示した 4 つの微小構造体についてビ ッカース硬度を調べた. ビッカース硬度, プローブ電流 値及び対応するプローブ電流密度(プローブ電流値をビ ームの照射面積で除した値)の関係を Fig. 3 に示す. な お,電流密度はプロープ電流値の低いものから 12, 20, 17, 7.5 A/cm²である. その結果, プローブ電流値 200 pA(電流密度 20 A/cm²)で作製した微小構造体の硬度が最 も高いことが分かった. 微小構造体のビッカース硬度と プローブ電流値には相関関係はなかった. しかし, ビッ カース硬度とプローブ電流密度の間には相関関係が見 られ,高いプローブ電流密度では高硬度な微小構造体を



Fig. 5 SIM image of a beam shaped micro structure.

作製できた.これは高いプローブ電流密度では微小構造 体が緻密化し,硬度が高くなったものと考えられる. 以上の結果,プローブ電流値 200 pA を本研究における 微小構造体の最適作製条件とした.以下に述べる微小構 造体の機械的性質や組織を評価する実験は,プローブ電 流値 200 pA で作製したものについて行った.

3.2 微小構造体の組織

Fig.4は,TEMで観察した微小構造体の断面である.このTEM像は全体が均一で,結晶の存在を示すような明瞭なコントラストは見られなかった.電子線回折図形を撮影した結果,アモルファスであることを示すハローリングが得られた.従って,微小構造体はアモルファス構造を有するため,機械的性質の異方性を持たないと判断される.

3.3 梁状微小構造体の曲げ試験による機械的性質の評価

Fig. 5 に,作製した梁状微小構造体の SIM 像を示す. 梁部分は長さ 25 μm×幅5 μm×厚さ5 μmで,両端の みが基板と固定されている.

ナノインデンターを用いて,梁の中央部に荷重 0.5 ml 及び 1 ml を作用させて曲げ試験を行った.得られた荷 重と変位の測定結果を Fig. 6 に示す.両荷重についての 測定結果は,ほぼ同一の曲線上にあることから,再現性 が確認された.また,負荷時と除荷時の荷重変位曲線が ほぼ同一で,ヒステリシスはほとんどなく,除荷後の変 位もほぼゼロであった.従って,このときの梁状微小構





造体の変形は弾性変形であると判断される. 梁状微小構 造体の 0.5 mN 及び 1 mN 負荷時の変位より,式(1)よ りヤング率を算出した. その結果,梁状微小構造体のヤ ング率は 20±2 GPa であった.

次に,梁状微小構造体の破壊強度を調べるため,さら に荷重を10 mN及び破壊に至るまで増加させて,曲げ試 験を行った.その測定結果の一例をFig.7に示すが,同 条件で行った再現実験でも同様な結果が得られた.梁状 微小構造体は荷重15 mNで変位が急激に増加した.よっ て,この荷重15 mNが梁状微小構造体の破壊荷重である と判断される.これより破壊強度を式(3)より算出し た結果,2.2±0.1 GPaであった.

得られた物性値の妥当性を判断する必要があるが,マ イクロ-ナノスケールの構造体では,前述したように外 形寸法や作製条件の違いによる表面構造および内部組 織の差異に起因した寸法効果があり定量的な比較は困 難である. M. Kiuchiら⁷⁾は本研究と同一の FIB-CVD によ りフェナントレンガスを用いて直径 100 nm 程度の炭素 細線を引張り試験によりヤング率 42.6-80.7 GPa, 破壊 強度 4.3 GPa と報告している. これらの値は本研究の結 果と比較するといずれも大きい.しかし,一般的に寸法 の減少に伴い強度等が増加すること 4-6)から、報告の試 験片サイズが本研究でのものより一桁程度小さいこと から、定性的にはこれまで知られている寸法効果による 変化と一致した傾向である. さらに, 3.1 節で述べたよ うに照射電流密度の変化による硬度変化などの試験片 作製条件の違いによる物性値の差異を考慮すると,本実 験結果の妥当性が示唆できる.

3.4 曲げ試験後の組織観察

梁状微小構造体の破壊の様子を詳しく調べるために, SEM を用いて破断部の観察を行った.梁状微小構造体の 破断部の SEM 像を Fig. 8(a),(b)に示す.(a)より構 造体内部にはボイドなどのマクロな欠陥はなく緻密な 組織である.また,破断部の形態及び,そこから飛散し



Fig. 7 Relationship between load and displacement of a beam shaped micro structure (maximum load : 10 mN and above). 作製された微小構造体の寸法スケールでの炭素材料固





Fig. 8 SEM images of a beam shaped micro structure fractured by bending test: (a) whole image, (b) region A.

有の性質であると判断される.

4. 結言

FIB-CVD により炭素から成る微小構造体を作製し,両端 固定の曲げ試験によりその機械的性質を調べた.その結 果,以下のことが明らかになった.

(1) 微小構造体の硬度はプローブ電流密度の影響を
受け,電流密度 20 A/cm²で最も高硬度な微小構造体を作
製できた.

(2) 数 µmスケールの試験片寸法を有する両端固定の 梁状微小構造体を FIB-CVD 法で一貫して作製できるプロ セスを確立できた.

(3) 梁状微小構造体は曲げ試験において弾性変形を示し、ヤング率は約 20±2 GPa であった.また、破壊荷重は 15 mN で破壊強度は 2.2 ± 0.1 GPa であった.

(4) 梁状微小構造体の破壊は脆性的であった.

(5) 微小構造体はアモルファス構造を有し、炭素と 6 at.%のガリウムを含む均一な組成とボイド等のマクロ な欠陥のない均一な組織であり、得られた機械的性質は 本炭素材料固有のものであった.

参考文献

- S. Matsui, T. Kaito, J. Fujita, M. Komuro, K. Kanda and Y. Haruyama: J. Vac. Sci. Technol. B18 (2000) 3181-3184.
- 2) T. Morita, R. Kometani, K. Watanabe, K. Kanda,

Y. Haruyama, T. Hoshino, K. Kondo, T. Kaito, T. Ichihashi, J. Fujita, M. Ishida, Y. Ochiai, T. Tajima and S. Matsui : J. Vac. Sci. Technol. **B21** (2003) 2732-2736.

- S. Matsui , J. Surface Finish. Soc. Jpn. 56 (2005) 361-366.
- M. D. Uchic, D. M. Dimiduk, J. N. Florando and W. D. Nix: Science 305 (2004) 986-989.
- C. Motz, T. Schöberl and R. Pippan: Acta Mater. 55 (2005) 4269-4279.
- 6) M. A. Haque and M. T. A. Saif: Acta Mater. 51 (2003) 3053-3061.
- M. Kiuchi, S. Matsui and Y. Isono: J. MEMS. 16 (2007) 191-201.
- S. Sundararajan and B. Bhushan: Sens. Actuat. A101 (2002) 338-351.
- J. Fujita, M. Ishida, T. Sakamoto, Y. Ochiai, T. Kaito and S. Matsui: J. Vac. Sci. Technol. B19 (2001) 2834-2837.
- S. Lee, C. Tekmen and W. M. Sigmund: Mater. Sci. Eng. A398 (2005) 77-81.